

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000
BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000, Thermally
Conductive, High Performance, Liquid, Gap Filling
Material



- Lämmönjohtavuus: 2.0 W/m-K
- Erittäin sopeutuva, suunniteltu herkille ja vähärasitteisille sovelluksille
- Kovettuu huoneenlämmössä nopeutetulla aikataululla
- 100 % kiinteä aine - ei kovettuvia sivutuotteita
- Erinomainen mekaaninen ja kemiallinen vakaus alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa



TUOTEKUVAUS

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000, Lämpöä johtava, korkean suorituskyvyn nestemäinen tilaa täyttävä aine

BERGQUIST® GAP FILLER TGF 2000 on korkean suorituskyvyn lämmönjohtava nestemäinen tilaa täyttävä aine, joka toimitetaan kaksikomponenttisena järjestelmänä ja kovettuu huoneenlämmössä tai kohotetuissa lämpötiloissa. Materiaali tarjoaa tasapainon kovetetun materiaalin ominaisuuksien ja hyvän puristussetin (muisti) välillä. Tuloksena on pehmeä, paikan päällä muotoutuva elastomeeri, joka soveltuu erinomaisesti "kuumien" elektronisten komponenttien kytkemiseen piirilevyn kiinnitetyn viereisen metallikotelon tai lämmönsiirtimen kanssa. Ennen kovettumista se virtaa paineen alla kuin rasva. Kovettumisen jälkeen se ei pumpptaannu rajapinnasta johtuen lämpösykleistä eikä ole kosketuskuiva.

Toisin kuin kovettuvat tilaa täyttävät materiaalit, nestemäinen menetelmä tarjoaa loputtomat paksuusvaihtoehdot vähäisellä tai olemattomalla rasituksella siirron ja kokoonpanon aikana. Se myös poistaa tarpeen tietyn paksuuden ja leikatun muodon erityisille tyynyille yksittäisissä sovelluksissa.

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000 on tarkoitettu käytettäväksi lämpöliitossovelluksissa, kun vahva rakenteellinen sidos ei ole tarpeen.

Vaihtoehdot ja kokoonpanot

Täytehelmet - Ei täytehelmiä, 0,007 tuuman täytehelmiä

Työaika - 15 minuuttia, 60 minuuttia, 600 minuuttia

Karttuusit - 50 cc, 400 cc

Paketit - 1200 cc, 10 galloniaa